ソルダーペーストSAC305: 適用 / 用途別

ディスペンスタイプ (S3X58-M406D / S3X70-M500D) (Sn 3.0Ag 0.5Cu) Type 4.5

ディスペンス用

ディスペンス用ソルダーペースト

「面」ではない、「点」のはんだ付け

- 高精度の吐出性と、高い溶融性を実現
- 長時間使用でも、安定した吐出形状
- 活性力が持続する設計で、部品を選ばず低ボイドを実現





S3X58-M330D (Sn 3.0Ag 0.5Cu) Type 4

レーザーはんだ付け対応ソルダーペースト (ディスペンス用)

熱負荷からの、解放

- 非接触加熱で基板や電子部品への負荷を回避
- 局所はんだ付け工程で不良率低減が可能
- 急加熱条件でのはんだ未凝集や飛散を抑制

ディスペンス用

レーザーはんだ付け対応

飛散抑制

ハロゲンフリー





S3X58-M330D

従来品

E150DN シリーズ (S3X58 / S3X70 / S3X811) (Sn 3.0Ag 0.5Cu) Type 4, 5, 6

ジェットディスペンス対応ソルダーペースト

ジェットディスペンス用

(ハロゲンフリー(CI + Br < 1500ppm))

70.811: N₂リフロー用

はんだを飛ばす、非接触の強み

- 高速非接触塗布で、生産タクトタイムを大幅短縮
- 独自フラックス技術で微小塗布性を実現
- マスクレス塗布・3D 実装など、異形部材への塗布も可能





1点目

5000点目

S3X70-E160DN (Sn 3.0Ag 0.5Cu) Type 5

ジェットディスペンス対応ソルダーペースト (Mycronic社承認)

Mycronic社ディスペンサー MY600, MY700対応

- 高速ジェットディスペンスで使用可能
- 良好な塗布性と溶融性を確保
- ハロゲンフリー (CI + Br < 1500ppm) に適合

ジェットディスペンス用 (ハロゲンフリー(CI + Br < 1500ppm) (N₂リフロー用



Mycronic社製 ジェット ディスペンス装置 MY700